

Petek, 06. marec 2026

Pozdravljeni,

pošiljamo vam pregled izbranih informacij in novosti s področja čipov, polprevodnikov ter aktivnosti KC Čip.si.

Aktualno

- **[KC Čip.si izdal Katalog svetovanj](#)**
Vabljeni, da si nov katalog podrobneje ogledate in nas kontaktirate, da prilagodimo izvedbo vašim zahtevam in željam.
- **[Sejem in razstava: embedded world 2026 "Connecting the embedded community"](#)**
10. -12. Marec 2026, Nuremberg, Nemčija
Embedded World je globalno srečanje strokovnjakov s področja vgradnih sistemov, ki ponuja hiter vpogled v najnovejše tehnologije – od komponent in modulov do programske in strojne opreme ter razvojnih orodij za kompleksne sisteme.
- **[Webinar: Life-Cycle Assessment of Semiconductor Chip Manufacturing](#)**
17. marec 2026, 11:00-12:30, on-line
V webinarju bodo na kratko predstavljene osnove metodologije LCA in njena uporaba pri proizvodnji polprevodniških čipov, skupaj s ključnimi trajnostnimi izzivi, kot so visoka poraba energije, emisije toplogrednih plinov, poraba vode ter raba kemikalij in redkih materialov.
- **[Summer School 2026: Inside the world of Microelectronics](#)**
23.- 28. Avgusta 2026, Bertinoro, Italija
Organizator: European Chips Skills Academy
Poletna šola ECS 2026 je namenjena dodiplomskim STEM študentom, ki želijo na hitro in praktično spoznati ključna področja mikroelektronike – od polprevodniških tehnologij in načrtovanja čipov do digitalnih sistemov ter vgradne inteligence – ter dobiti vpogled v kariere v rastoči industriji čipov.
- **[Webinar: Green Chips, Clean Future](#)**
23. marec 2026, 4:00-16:00, on-line, ECSA
Dogodek bo predstavil primerjave materialov, ključne mehanske in funkcijske izzive, testne metode ter strategije načrtovanja za bolj stabilna in zanesljiva BioPCB vezja
Registracija: [Green Chips, Clean Future Webinar](#)

Izpostavljeni razpisi:

Polprevodniki:

- [**HORIZON-HLTH-2026-01-TOOL-03**](#): Integrating New Approach Methodologies (NAMs) to advance biomedical research and regulatory testing
Rok za prijavo: 16. april 2026, 17:00

Fotonika:

- [**DIGITAL-JU-CHIPS-2026 -SKILLS-HoE-SG**](#): Skills Hubs of Excellence
Rok za prijavo (FPP phase): 17. September 2026, 17:00
- [**HORIZON-CL4-2027-05-DIGITAL-EMERGING-03**](#): Advanced integrated photonic devices for extended features and ultra-low power consumption (RIA) (Photonics Partnership)
Rok za prijavo: 18. marec 2027, 17:00

Kvantna tehnologija:

- [**HORIZON-CL3-2026-02-CS-ECCC-03**](#): Advanced cryptographic schemes and High-Assurance high-speed cryptographic implementations
Rok za prijavo: 15. septemember 2026, 17:00

Zanimivosti s področja:

- [**Chips Act II: Reinforcing Europe's automotive semiconductor supply chain \(CLEPA Position paper\)**](#)
Stališče združenja CLEPA, naj prenovljeni evropski Chips Act okrepi celotno vrednostno verigo avtomobilskih polprevodnikov ter izboljša odpornost in konkurenčnost evropske industrije.
- [**NanoIC opens access to first-ever fine-pitch RDL and D2W hybrid bonding interconnect PDKs**](#)
Imec je izdal dva prva tovrstna napredna načrtovalska kompleta za medsebojne povezave (PDK): PDK za fino-razmaknjeno preusmeritveno plast (RDL fine-pitch redistribution layer) ter PDK za hibridno vezavo čip-na-rezino (D2W die-to-wafer)
- [**China's top chip execs claim ASML alternative 'small, fragmented, and weak'**](#)
Kitajski industrijski velikani pozivajo k nacionalnemu naporu za vlaganje v napredna orodja za proizvodnjo čipov.
- [**China seeks to enhance rare earth advantages, take 'extraordinary measures' to achieve semiconductor breakthroughs**](#)
Nov petletni načrt za okrepljeno prizadevanje k višji stopnji tehnološko samostojnosti.
- [**Intel CEO embraces its 18A node for external customers as 18A-P gets 'inbound interest'**](#)
Stabilnost, ponovljivost in izkoristek proizvodnega procesa se postopoma približujejo industrijskim standardom.
- [**Meta Plans to Develop Custom Chips to Train Its AI Models**](#)
Kljub nedavnim velikim dogovorom z vodilnimi izdelovalci čipov, Meta še naprej razvija lastne procesorje – tudi takšne, namenjene treniranju prihodnjih modelov umetne inteligence.
- [**Taiwan Builds the Future**](#)
Povečevanje vlaganj v izobraževanje, raziskave in razvoj, mednarodno sodelovanje ter napredne sistemske zmogljivosti.

- **MIPS, GlobalFoundries Bet on Physical AI**

Pospeševanja razvoja »physical AI«, pri čemer MIPS s prehodom na RISC-V krepi svojo vlogo v avtomobilski industriji in novih realnočasovnih sistemih

Lep pozdrav,

vaš KC Čip.si



Slovenski kompetenčni center za čipe in polprevodniške tehnologije

KC Čip.si - glavna pisarna

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Tržaška cesta 25, Ljubljana

E-pošta: office@cc-chip.si

Tel.: 01 476 88 50

Spletna stran (v izdelavi): <https://cc-chip.si/>



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREENBRAZBO

Projekt CC Chip.si (št. 101217674) je sofinanciran s strani Chips Joint Undertaking in Evropske unije v okviru programa Digital Europe.

To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavili na prejemanje novic KC Čip.si ali izrazili interes za obveščanje o naših dejavnostih.

Če novic ne želite več prejemati, se lahko kadarkoli odjavite.

[Odjava](#)

